

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2016年4月28日(28.04.2016)



(10) 国際公開番号
WO 2016/063909 A1

- (51) 国際特許分類:
C09J 163/00 (2006.01) H01L 21/52 (2006.01)
C09J 11/06 (2006.01) H01L 25/065 (2006.01)
C09J 145/00 (2006.01) H01L 25/07 (2006.01)
C09J 157/10 (2006.01) H01L 25/18 (2006.01)
C09J 201/00 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2015/079692
- (22) 国際出願日: 2015年10月21日(21.10.2015)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2014-217744 2014年10月24日(24.10.2014) JP
- (71) 出願人: 住友ベークライト株式会社(SUMITOMO BAKELITE CO., LTD.) [JP/JP]; 〒1400002 東京都品川区東品川2丁目5番8号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者: 橋本 和美(HASHIMOTO, Kazumi); 〒1400002 東京都品川区東品川2丁目5番8号 住友ベークライト株式会社内 Tokyo (JP). 堀井 誠(HORII, Makoto); 〒1400002 東京都品川区東品川2丁目5番8号 住友ベークライト株式会社内 Tokyo (JP). 杉山 広道(SUGIYAMA, Hiromichi); 〒1400002 東京都品川区東品川2丁目5番8号 住友ベークライト株式会社内 Tokyo (JP).
- (74) 代理人: 朝比 一夫, 外(ASAHI, Kazuo et al.); 〒1050003 東京都港区西新橋1丁目18番9号 西新橋ノアビル4階 Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JP, KE, KG, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユー

[続葉有]

(54) Title: PHOTSENSITIVE ADHESIVE COMPOSITION AND SEMICONDUCTOR DEVICE

(54) 発明の名称: 感光性接着剤組成物および半導体装置

[図1]

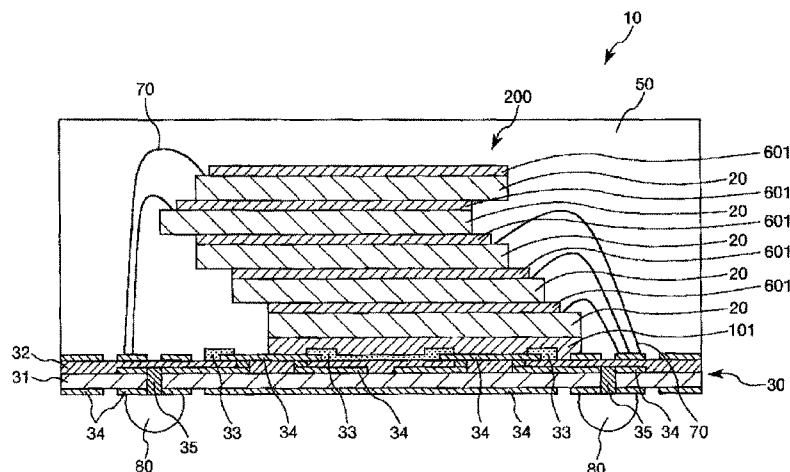


FIG.1

(57) Abstract: This photosensitive adhesive composition is characterized by containing (A) an alkali-soluble resin, (B) a photoacid generator, (C) an epoxy compound, and (D) a phenol compound having a melting point of 50–150 °C. By using a cured product of the photosensitive adhesive composition as an adhesive layer that adheres semiconductor elements to one another, it is possible to prevent bubbles (voids) from forming in an interface between the adhesive layer and a semiconductor element, and, even when bubbles form in the interface, to remove said bubbles. As a result, it is possible to enhance the adhesiveness (close adhesion) of semiconductor elements to one another.

(57) 要約:

[続葉有]



WO 2016/063909 A1



ロシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨー 添付公開書類:

ロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, — 国際調査報告 (条約第 21 条(3))
ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV,
MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK,
SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ,
GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

本発明の感光性接着剤組成物は、(A) アルカリ可溶性樹脂と、(B) 光酸発生剤と、(C) エポキシ化合物と、(D) 融点が 50～150℃であるフェノール化合物と、を含むことを特徴とする。本発明の感光性接着剤組成物の硬化物を、半導体素子同士を接着する接着層として用いることで、半導体素子と接着層との界面に気泡(ボイド)が発生することを低減することができ、また、界面に気泡が発生してもその発生した気泡を除去することができる。その結果、半導体素子同士の接着性(密着性)を高めることができる。